



Leiterplatten (PCBs)

Flexible, starr-flexible und starre Leiterplatten

Cicor entwickelt und produziert seit über 50 Jahren anspruchsvolle flexible, starr-flexible und starre Leiterplatten von der Idee, über Prototypen bis hin zur Grossserienproduktion. Dank der umfassenden Fachkompetenz im Bereich der Multilayer-Boards (MLBs), Multi-Chip-Module (MCMs), High-Density-Interconnects (HDIs) und Reel-to-Reel-Technologie entwickelt Cicor innovative und zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung,

Automobilindustrie sowie den Kommunikations-, Industrie-, Uhren- und Konsumgütermärkten. Dünne Materialien sowie Leiter- und Abstandsbreiten bis 25 μm ermöglichen eine weitere Miniaturisierung und fortschrittliche Ultra-HDI-Lösungen. Die DenciTec[®] Technologie eröffnet dafür vollkommen neue Möglichkeiten. Durch die Kombination von PCB-Verfahren und der Dünnschichttechnologie lassen sich innovative Schaltungen herstellen.





Portfolio

Flexible Leiterplatten

- Ultra High Density Interconnect
- Flex-Schaltungen (1 bis 8 Lagen)
- Polyimidfolien mit einer Dicke von nur 12,5 µm
- Klebebinden ab einer Dicke von 15 µm
- Gestapelte Vias und Via-in-Pad-Strukturen, die durch kupfergefüllte Blind Vias ermöglicht werden
- Hochpräzises Laserkonturschneiden

Starr-flexible Leiterplatten

- High-End-/Qualitätsbasismaterialien wie High-Tg/Low-CTE FR4 in Kombination mit Polyimidfolien
- Ersatz von starren Leiterplatten, Verbindungsteilen, Kabeln oder separaten flexiblen Leiterplatten durch die Integration der Verbindung verschiedener Teile in eine einzige starr-flexible Leiterplatte
- Reduzierung der Bauteilgrösse und Möglichkeit einer dreidimensionalen Montage bestückter Leiterplatten
- Verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Umgebungen, in denen Vibrationen, Beschleunigungen und andere schwere Bedingungen auftreten
- Reduzierter Logistikaufwand durch Ersatz mehrerer Komponenten durch eine einzige Leiterplatte

Starre Leiterplatten

- Starre Leiterplatten mit 1-20 Lagen mit klarem Fokus auf die Miniaturisierung in der x-y- und z-Achse
- (Ultra-) dünne High-End-Basismaterialien mit Ausdehnungskoeffizientenwerten von weniger als 8 ppmK-1 in der x- und y-Achse

DenciTec®

- Leiterzugsbreiten und -abstände bis zu 25 µm
- Kupferdicken von 20 ± 5 µm auf allen Lagen
- Laser-Via-Durchmesser von 30 µm
- Restringe mit von 30 µm auf den Innenlagen und 20 µm auf den Ausenlagen
- Kupfergefüllte Blind-Vias mit der Möglichkeit zum Via-Stacking und Vias in Pads
- Ultradünne Schaltkreise durch Einsatz eines 12,5 µm Polyimid-Kernmaterials (4-Schicht-Flex-Schaltkreise mit weniger als 120 µm Dicke)

3D-MID

- Spritzguss
- Laseraktivierung
- Metallisierung
- Bestückung
- Endprüfung
- Industrialisierung

Märkte



Industrie



Medizin



Luft-/Raumfahrt und Verteidigung



Uhren und Konsumgüter



Automobil und Transport



Kommunikation



Cicorel SA, Boudry
info-pcb@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2100 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten, gedruckte Elektronik, Hybridschaltungen und Substrate sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss.

Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.



cicor.com